2024年度事業報告書

自：2024年4月1日　至：2025年3月31日

1. 概要

大会事業では、国際会議ICEP2024、第34回マイクロエレクトロニクスシンポジウム（MES2024）、第39回春季講演大会、2024ワークショップ（修善寺）など、現地開催とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式を採用し前年とほぼ同様の事業展開ができた。各事業では多くの発表者や聴講者を集めることができた。近年の半導体産業の再興と戦略的再編がエレクトロニクス実装学会の活動の活性化の一因と考えられる。学会誌発行は計画通りに和文論文誌を年7回、英文論文誌を1回発行した。和文誌には研究論文など5件、英文論文誌にはテクニカルペーパー6件を掲載した。

2. 学会運営

(1) 総務委員会

学会運営において持続可能な運営を実現するために事務局は長期的な業務効率化、負荷の偏重改善、職場環境の改善を継続的に実施してきた。業務についても在宅と事務所での勤務形態も定着してきた。更にAI（CatGPT）やWEB会議の録音機能を駆使し業務の効率化を図ってきた。

(2) 財務委員会

持続可能な学会運営を行うために、財務基盤の確立と財務体質の安定化を目指してきた。今年度は、半導体などの環境変化に後押しされ、各大会事業、教育事業、支部事業では、過去最多の参加者が集まり収益改善が図られた。

(3) 広報委員会

学会のホームページとメールマガジンを活用し広く学会情報を発信してきた。さらに、Xを開設し、より若い層への発信をこころみた。

(4) 会員増強委員会

大会事業イベントや公開研究会を通じて参加者に勧誘活動を実施した。今年度は、正会員、賛助会社、学生会員の新規登録者が369名で退会者が229名で140名の会員増となった。

(5) ミッションフェロー

平成26年（2014年）3月から17名でスタートしたミッションフェローは、第11期、第12期メンバーで、現在17名が活動の母体となっており、若手中心に様々な企画を展開し工場見学会や独自講演会などを積極的に推進し活動を広げている。

(6) 日本電子回路工業会（JPCA）との連携

産業界との連携において重要なパートナーであるJPCAと情報共有を深めるために、公開研究会を協賛、会費を会員価格で対応し多くの参加をいただいた。

3. 大会事業活動報告（定款第4条第1号関係）

国際会議ICEP2024は現地開催、第34回マイクロエレクトロニクスシンポジウム（MES2024）と第39回春季講演大会は、現地開催とオンラインによるハイブリット開催を実施。対面でのコミュニケーションとオンラインによる参加の利便性を上げ、より多くの参加をいただいた。ワークショップはラファーレ修善寺で開催を実施した。

(1)「国際会議ICEP2024」（組織委員長　畠山友行氏　富山県立大学）

2024年4月17日(水)～20日(土)、富山国際会議場（富山県富山市）にて、IEEE EPS Japan Chapter、IMAPS、SMTAと共催で「国際会議 ICEP2024」を開催した。以下の4件のKeynote Lecture

があった。

・「RUMS – A New Business Scheme to Accelerate Innovation Through Integration of Front-End and Back-End of Semiconductor Technologies」 Atsuyoshi Koike, Rapidus

・「The Chiplet Challenge 」Beth Keser, Zero ASIC

・「Glass packaging for Emerging Applications in Advanced Communications and AI 」 Madhavan Swaminathan, The Pennsylvania State University

・「Inflection Point on Next Package Solution」 Sa-Yoon Kang, President of KMEPS

総計 179 件(Keynote 4 件含む)の口頭発表、38 件のポスター発表があった。発表者も含めた参加者は 705 名。

(2)「第 34 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム 2024」(組織委員長：山田 靖教授大同大学)

2024 年 9 月 11 日（水）から 13 日（金）大同大学の会場とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式にて開催。講演・発表件数は 108 件（特別講演、依頼講演、企業展示発表、ポスターセッション、特別セッション、ロードマップセッション、スマートプロセスセッション含む)、企業展示 18 社、参加登録人数は昨年より 47 名減少の 465 名であったが現地参加数は 190 名～272 名と約 70 名の増加となった。

9 月 11 日は、特別セッション「エレクトロニクス実装における機械学習の応 用例と展開」、「未来をつくれ！若手技術者の大活躍推進」セッションにて初のパネルディスカッションを実施、ロードマップセッション、電子デバイス実装研究委員会共催スマートプロセスエレクトロニクス生産部会の講演。

9 月 12 日特別講演では、学校法人大同学園　理事長 武藤 大 氏の「企業経営と大学経営　双方に携わって思うこと」、三菱電機株式会社 コンポーネント製造技術センターパワーデバイス・モジュール技術推進部 部 別芝 範 氏による「三菱電機のパワーモジュールの技術動向」の特別講演を実施。昨年同様、2 会場でのサテライトにて対応するほどの人気であった。

今回初のポスターセッションでは、午前にショートプレゼンテーション、コアタイムにてポスター前での説明があり質問が活発にされていた。企業展示は 18 社と過去最高となり、多種多様のコミュニケーションの場となっていた。

交流会は、137 名参加、途切れることのないお料理に満足いただき盛会となった。

昨年と同様の開催会場であったためスムーズに実施することができた。

(3)「2024 JIEP ワークショップ」　(実行委員長：渡辺尚徳氏（東芝))

2024 年 10 月 10 日(木)11 日、メインテーマ『日本の半導体産業復権を支える実装技術』、サブテーマを「部品・材料・装置・プロセス日本の強みを探求！」と掲げ、ラフォーレ修善寺サンパティックホールにて開催した。恒例の招待講演「世界をリードする日本の部品技術」(梶田 栄氏 NPO サーキットネットワーク)、ナイトセッション「装着型サイボーグ HAL®の活用法」(安永 好宏様 CYBERDYNE 株式会社) を企画した。発表 49 件、参加者は 101 名。ラフォーレ修善寺での 1 泊 2 日の開催となり、活気あふれる討論が随所で見られた。

(4)「第 39 回エレクトロニクス実装学会春季講演大会」組織委員長前山 利幸教授（拓殖大学）

3 月 11 日(火)～13 日(木)拓殖大学文京キャンパスの会場とオンラインにて開催。スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学学会の共催と特別講演では拓殖大学理工学総合研究所の共催もいただいた。

講演件数 154 件（特別講演、依頼講演、MES ベストペーパー賞受賞講演、チュートリアル講演、スマートプロセス学会 有機無機講演、ポスター、企業展示発表を含む)、参加登録人数 729 名、現地参加も連日 300 人超え、交流会参加 170 名といずれも近年最高となった。

3 月 11 日はチュートリアル講演、12 日は初企画の MES2024 ベストペーパー賞の受賞講演、ポスター・企業展示のコアタイム、MES2024 の表彰式、特別講演、交流会、13 日はスマートプロセス学会 第 24 回有機無機接合研究委員会の講演を実施した。
特別講演は、東拓殖大学 政経学部 教授 丹羽 文生 氏の「緊迫化する中台関係と日本外交」と Tenstorrent Japan KK Country Manager,Japan 中野 守 氏と Tenstorrent Inc, RISC-V Architect Gr Fellow 石井 康雄 氏による「Empowering AI Innovation with Versatile and Open-source RISC-V Processor」広い講堂で行われ質問も多く好評であった。

4. 展示会運営委員会活動報告（定款第 4 条第 1 号関係）

JPCA Show と同時開催するマイクロエレクトロニクスショーの企画として、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ、eX-tech を企画した。

(1)「最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ及び、eX-tech 2024」

JPCA Show（2024 年 6 月 12 日～6 月 14 日、東京ビッグサイト）と同時開催するマイクロエレクトロニクスショーの展示企画として、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ、および eX-tech 2024 を東京ビッグサイトで実施しました。最先端実装技術シンポジウムには 610 名の参加者が集まった。

(2)「セミコン・ジャパン 2024」への展示

2024 年 12 月 11 日～13 日、セミコン・ジャパン 2024 には、3D チップレット研究会ブースと学会ブースの 2 つのブースを展示し広く学会活動をアピールしました。特に APCA ブースでの 3D チップレット研究会ブースには多くの方々が来場された。

(3)「EgeTech2024」への展示

2024 年 11 月 20 日から 22 日 パシフィコ横浜で実施し、EgeTech2024 にﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘｽｷｬﾝ研究会が展示担当として参加、ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加校/研究室 20 ﾌﾞｰｽに訪問し JIEP の紹介をした。

5. 技術調査事業活動報告（定款第 4 条第 2 号関係）

昨年度から 11 の技術委員会と 24 の研究会体制で運営しており、2024 年度も昨年度と同様に現地開催とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式を実施した。ハイブリッド形式により昨年度と同等の安定した集客が実現でき広範な情報発信が行われた。今後も日本の実装技術の発展に向け、新たな領域の実装技術研究会を積極的に立ち上げていく方針である。

(1) 技術委員会の活動

11 の技術委員会を組織し、実装技術分野の技術動向を調査しました。特に「エレクトロニクス実装技術の現状と展望」と題した特集記事を学会誌 1 月号に掲載した。また、大会事業や展示会事業、各種イベントの企画運営を各委員会が支援し、活性化を図った。

(2) 研究会の活動

各技術委員会の傘下に合計 24 の研究会を組織し、具体的な実装技術テーマについて調査活動を行いました。委員相互の情報交換を促進するため、ハイブリッド形式の会議を活用して活発な議論を行なった。また、34 回の公開研究会と 1 回の EMC 実践講座を開催し、そのうち 31 回は現地とオンラインのハイブリッド形式で行われた。

(3) 技術調査事業活動成果の普及

技術委員会および研究会の活動で得られた成果について、公開研究会や学会誌などで広く公開した。公開研究会は合計 34 回開催され、延べ 3,684 名の参加者があった。

担当研究会等	開催日	会場	参加人数	概要
材料・環境技術委員会公開研究会	2 月 20 日	オンライン開催	51 名	初めて海外組織である台湾 ITRI と連携した。ITRI の評価プラットフォームを含む取組みについて発表。
システム設計研究会 公開研究会	12 月 3 日	回路会館（ハイブリッド開催）	45 名	2.4GHz 帯電波干渉検知システムの複素量評価に関する一検討 ITO 薄膜を利用した透明コプレーナ線路の伝送特性の検討 スパイラルコイルを利用した生体内外間通信における電磁的生体安全性の検討 磁界ばく露が認知機能、情動および抑うつ様行動に及ぼす作用の評価 マイクロ波マンモグラフィ用脂肪等価ファントムの試作および評価 の 5 件の研究発表と質疑応答、優秀なものを表彰
EMC 設計技術実践講座	5/29～2/21 (全 13 回)	回路会館（ハイブリッド開催）	28 名	共通のベース回路を 5 グループに分かれ EMC 対策設計～遠方界/近傍界の測定及び対策会を実施し、基板改版まで実施した。
サマーセミナー	8 月 27 日	AIRBIC（ハイブリッド開催）	118 名	テーマ：「最新のシミュレーション技術と EMC 設計」（講演件数：6 件）
EMC モデリング公開研究会	2 月 28 日	回路会館（ハイブリッド開催）	70 名	テーマ：「EMC に関連したシミュレーション技術の研究」（講演件数：7 件） 研究会メンバーによる 1 年間の研究成果報告の場として講演会を企画
先端ファブリケーション研究会 公開研究会	11 月 22 日	回路会館（ハイブリッド開催）	78 名	テーマ：「プリント配線板製造におけるドライプロセス/ウェットプロセス最新技術動向」（講演件数：5 件）
次世代配線板 公開研究会	1 月 29 日	オンライン開催	72 名	これまでの研究成果を基に、最終報告公開研究会を実施。また、ランドレスビア実現の重要技術である露光について、最新の技術動向を依頼講演。
信頼性解析技術委員会 公開研究会	1 月 30 日	回路会館（ハイブリッド開催）	88 名	テーマ：「３D・チップレットを実現する信頼性技術と課題」（講演件数：4 件）近年課題に挙がっている基板マイクロビア信頼性や、最先端チップレット、パッケージングの信頼性課題について議論。
先進実装・電子部品研究会 公開研究会	7 月 22 日	回路会館（ハイブリッド開催）	86 名	テーマ：「電子部品・実装技術に係る要素技術の紹介」（講演件数：10 件） 主に半導体に関わる工法や材料について講演が行われ、質疑応答により知見や認識を深めた。
インターコネクション研究会 公開研究会	11 月 25 日	回路会館（ハイブリッド開催）	66 名	テーマ：「注目される最先端インターコネクション技術の動向」（講演件数：4 件） 実装技術に関して講演が行われ、技術紹介や実用化に向けた課題について議論が行われた。
検査技術委員会 公開研究会	12 月 13 日	シーメンス EDA ジャパン（対面）	51 名	研究会テーマ 実装基板検査の「いま」と「みらい」

				～日産自動車の実例にみる製造現場の課題と解決～
第 84 回 OPT 公開研究会	7 月 26 日	京セラみなとみらい（ハイブリッド開催）	219 名	・『ＡＩと光インターコネクトがもたらすコンピューティングの新時代』と題してオンライン／オンサイトのハイブリッドで開催した。 ・AI/ML の発達によるデータセンターのシステムのアーキテクチャやデバイスの動向や開発状況ついて，計 4 件講演いただき，講演後のオーサーインタビューも含め，活発な質疑応答があった。
第 85 回 OPT 公開研究会	10 月 25 日	慶應義塾大学（ハイブリッド開催）	216 名	・『大規模 AI システムを実現するアクティブ光デバイスおよび実装技術の最新動向』と題してハイブリッドで開催した。 ・短距離通信用次世代光デバイス素子候補の各開発技術について海外講演 1 件を含む計 4 件の講演を実施し，講演後のオーサーインタビューも含め，活発な質疑応答があった。
第 86 回 OPT 公開研究会	1 月 16 日	京都工繊大（ハイブリッド開催）	249 名	・『新時代を切り拓く最新の光回路実装技術』と題して開催した。 ・初の関西開催で，シリコンフォトニクス関連の実装技術の様々なカテゴリから功績賞受賞講演 1 件を含む計 4 件の講演を実施し，講演後のオーサーインタビューも含め，活発な質疑応答があった。
システムインテグレーション実装技術委員会公開研究会	6 月 28 日	ナガセグローバル人財開発センター（ハイブリッド開催）	378 名	3D・チップレット研究会公開研究会 テーマ：「3DIC・Chiplet 実装技術戦略と業界動向」（講演件数：4 件） ＋協力企業紹介など
システムインテグレーション実装技術委員会公開研究会	12 月 6 日	オムロン京都センタービル（ハイブリッド開催）	298 名	3D・チップレット研究会公開研究会 テーマ：「3DIC・Chiplet に関わる最新実装技術と開発動向」（講演件数：4 件） ＋協力企業紹介など
部品内蔵公開研究会（1）	6 月 27 日	回路会館（ハイブリッド開催）	140 名	テーマ：「部品内蔵技術と高密度・高機能化を支える実装材料」 （講演：5 件）
部品内蔵公開研究会（2）	10 月 1 日	回路会館（ハイブリッド開催）	65 名	テーマ：「部品内蔵技術と高機能化を支える配線技術」 （講演：5 件）
部品内蔵公開研究会（3）	12 月 19 日	回路会館（ハイブリッド開催）	195 名	テーマ：「部品内蔵・高密度配線板と高速伝送を支える基板材料」 （講演：5 件）
部品内蔵公開研究会（4）	2 月 26 日	回路会館（ハイブリッド開催）	137 名	テーマ：「部品内蔵技術と配線板の高機能化を支える実装材料」 （講演：5 件）

スペースエレクトロニクス公開研究会	11 月 21 日	回路会館（ハイブリッド開催）	95 名	テーマ：「宇宙用 電子機器の現状と課題」（講演：5 件）とパネルディスカッション「宇宙用電子機器の課題と解決に向けた方向性」を実施
スペースエレクトロニクス公開研究会	2 月 4 日	回路会館（ハイブリッド開催）	59 名	テーマ：「宇宙事業に関連する取組の現状と課題」（講演：４件）とパネルディスカッション「宇宙事業に取り組む現状および課題と解決に向けた方向性」を実施
サーマルマネジメント公開研究会	10 月 30 日	回路会館（ハイブリッド開催）	108 名	ヒートパイプ技術をテーマとして、計 4 件の講演で構成した。
サーマルマネジメント公開研究会	3 月 24 日	回路会館（ハイブリッド開催）	65 名	熱物性や測定技術に関して、計 4 件の講演で構成した。
カーエレクトロニクス公開研究会	9 月 17 日	回路会館（ハイブリッド開催）	67 名	第１回公開研究会「モビリティ・GX と要素技術の動向」を開催
カーエレクトロニクス公開研究会	2 月 10 日	回路会館（ハイブリッド開催）	49 名	第 2 回公開研究会「サーキュラーエコノミー・脱炭素と車載実装技術」を開催
パワーエレクトロニクス研究会公開研究会	2 月 19 日	回路会館（ハイブリッド開催）	91 名	パワーエレクトロニクス動向、車載向け動向に加え、影響が大きいと予想するエレクトロマイグレーションに関しての講演・議論
ヘルスケアエレクトロニクス公開研究会	8 月 26 日	I-site なんば（ハイブリッド開催）	57 名	テーマ：次世代ヘルスケア・医療分野におけるエレクトロニクス技術～生成 AI への挑戦（講演：５件）
ヘルスケアエレクトロニクス公開研究会	1 月 29 日	ナガセグローバル人財開発センター（ハイブリッド開催）	49 名	テーマ：「次世代に向けた夢の技術～人生 100 年時代における快適な生活を実現するヘルスケアエレクトロニクス」（講演：５件）
インテリジェント第1回公開研究会	6 月 21 日	オンライン開催	59 名	｢｢機械学習のための時系列データ特徴量とそのモデル｣ 講師による講演と Python を用いた実習を実施
インテリジェント第2回公開研究会	9 月 20 日	オンライン開催	37 名	「画像生成 AI を使用した検査について」講師による講演と Python を用いた実習を実施
インテリジェント第3回公開研究会	11 月 20 日	群馬大学（ハイブリッド開催）	13 名	「センサから取得した時系列データの信号処理への機械学習適用」講師による講演と Python を用いた実習を実施
ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘｽｷｬﾝ公開研究会	9 月 18 日	回路会館（ハイブリッド開催）	48 名	特別講演：産業タイムズ社会長 泉谷渉氏「半導体産業は今や国家安全保障の要、世界経済の引っ張り役！」ほか 3 件発表「バウンダリスキャンテストと CAE の連携による HALT 試験における BGA 信頼性評価」 (株)先端力学シミュレーション研究所 前澤祐氏

最先端めっき実装研究会 公開研究会	7 月 24 日	回路会館 （ハイブリッド開催）	168 名	基調講演 2 題とガラスへのめっきに関する学術講演 1 題と委員企業の講演などを実施。
最先端めっき実装研究会 公開研究会	7 月 24 日	大阪公立大文化交流センター （ハイブリッド開催）	114 名	最終表面処理関連と接合に関連した基調講演 1 題と接合関連のめっき技術の企業講演を 3 題実施。

6. 教育事業活動報告（定款第 4 条第 3 号関係）

AI^{2}OT 講座は現地、PWB 製造初級コース、エレクトロニクス実装基礎講座については、オンデマンド方式、伝熱解析セミナー（初級、中級）については、ハイブリッド方式と各講座の特性に合った方式で講座を開催した。

教育講座の実施

① AI2OT 講座（2024 年 10 月 17 日 18 日（座学）、11 月 14 日 15 日（実習）：北海道大学東京事務所で開催）受講者は座学 4 名、実習 4 名

② PWB 製造・初級コース（2025 年 1 月 6 日～31 日：オンデマンド開催）
新入社員、営業担当者向けに、広い技術分野にまたがるプリント配線板について、基礎知識の修得を目標とした初級コースの教育講座を実施した。受講者は 20 名。

③ 伝熱解析セミナー（初級、中級）（2024 年 12 月 17 日、2025 年 2 月 17 日ハイブリッド開催）
伝熱解析セミナーとして初級、中級をハイブリッドで実施し、内容も大幅にリニューアルした。前年を大幅に上回る 32 名の参加者があった。

④ エレクトロニクス実装基礎講座（2024 年 12 月 16 日－1 月 15 日オンデマンド方式）
これまでエレクトロニクス実装技術の講座が中断していたが、今年度新たな講師を迎え再開した。オンデマンド方式で実施し、67 名の参加者を得た。今後も中心講座として運営を実施していきたい。

7. 会誌発行委員会活動報告（定款第 4 条第 4 号関係）

会誌発行委員会活動報告（定款第 4 条第 4 号関係）

学会誌 7 回および英文論文誌 1 回を発行した。また 3 月号、7 月号、8 月号、11 月号については、オンライン版のみでの発行を実施した。

(1) エレクトロニクス実装学会誌の発行

エレクトロニクス実装学会誌は例年通り、7 回発行されました。研究開発活動の成果として、研究論文、速報論文、技術報告など 5 件が掲載され、会員に対して実装技術に関する最新情報を提供しました。また、学会活動状況についても広報し、J-STAGE からのダウンロード数は年間 240,195 件でした

(2) 英文論文誌の発行

2024 年 12 月に、英文論文誌 Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging Vol.16 を発行しました。この英文論文誌は、論文が採択された後、随時 WEB で公開され、会員外の海外の方々に広く読まれるよう積極的にアピールしています。J-STAGE からのダウンロード数は年間 31,904 件でした。

(3) 日経クロステック（xTECH）への抜粋転載

2024 年度には転載はありませんでした。日経クロステック（xTECH）は、他の技術分野を含む幅

広い技術領域から多くの読者を抱えており、学会活動の広報の場や学会 WEB へのアクセス窓口として今後の活用が期待される。

8. **国際事業活動報告**（定款第 4 条第 5 号関係）

ICEP ステアリング委員会を開催し、2027 年までの組織委員長を決定した。また IEEE EPS と IEEE EPS Japan　Chapter との MOU 締結を実施した。

9. **支部事業活動報告**（定款第 4 条第 6 号関係）」

(1)関西支部

・**「実装フェスタ関西 2024」**2024 年 7 月 4 日(木)～5 日(金)、パナソニックリゾートにて開催。
参加者 249 名と昨年より 49 名増加、早期割引期間に定員に達する人気となった。
基調講演 2 件、特別講演 1 件、招待講演 6 件、ポスター49 件、ナイトセッションでは 6 名の講師によるイブニングセッションがあり希望者多数のセッションは広い会場に変更するほどであった。スポンサー13 社とのビュッフェを初導入し 15 人の学生が参加となり大好評であった。

・**「第 31 回若手研究会セミナー」**2024 年 7 月 30 日、大阪公立大学文化交流センターとオンラインにて開催。
～伝熱の基礎から半導体構造と材料の熱分析まで～　のテーマで３件の講義を実施し参加者は 71 名であった。

・**「第 11 回ぷらっと関西 2024」**2024 年 11 月 1 日(金) オムロン株式会社草津工場にて開催。
定員 30 名のところ 37 名の参加があり、オムロン X 線検査装置・自動ライン見学を行った。

・**「第 22 回技術講演会」**2025 年 2 月 27 日大阪公立大学 I-site なんばにて開催。
「無加圧シンタリングに関連する材料・接合技術の最新動向」をテーマに基調講演 1 件、技術講演 5 件、参加者 81 名であった。

(2)北海道東北支部

2024 年 7 月 9 日にナノテラス見学会＆先端半導体・実装・パッケージングセミナーを開催した。北海道東北支部では、支部として、初めての独自開催を実施した。ナノテラス見学会とセミナー（講師４名）を開催し、７６名の参加をいただき、アンケート結果も好評だった。

10. **表彰委員会活動報告**（定款第 4 条第 6 号関係）

例年どおりエレクトロニクス実装技術分野の学術・技術的な進歩発展への貢献や学会の発展・運営に貢献した方々及び各大会の優秀発表を表彰した。

(1) 学会賞（1 件）
「副会長として当学会貢献（2010 年 6 月～2012 年 6 月）」
若林信一（長野県産業振興機構、コネクテックジャパン株式会社、公立大学法人長野大学）
(2) 功績賞（1 件）
「学会活動および他学会連携した実装技術発展への貢献」
羽深等（国立大学法人横浜国立大学）
(3) 功労賞（2 件）
「エレクトロニクス実装・接合技術および学会活動への貢献」
三宅敏広（車載エレクトロニクス実装研究所）
「部品内蔵技術の国際標準化活動および学会活動への貢献」
加藤義尚（福岡大学）
(4) マイスター賞（1 名）
「半導体製造装置生産における、IE（インダストリアルエンジニアリング）を活用した生産性改善技術の貢献」

伊藤高明（株式会社荏原製作所）
(5) 論文賞（2 件）
「プラズマモニターを用いたプラズマクリーナーにおける予知保全」
白水博（パナソニックコネクト株式会社）、
丹正淳文、翁振雄（日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社）、
田村好司、峯孝太郎、小川正太郎、勝山ちひろ（パナソニックコネクト株式会社）
「Electromigration in Tin-bismuth Planar Solder Joints」
Prabjit Singh、Larry Palmer、Thomas Wassick（IBM Corporation）、
Raiyo Aspandiar、Brian Franco（Intel Corporation）、Haley Fu（INEMI）、
Richard Coyle、Faramarz Hadian（Nokia）、Vasu Vasudevan（Dell Technologies）、
Aileen Allen（HP Inc.）、Keith Howell（Nihon Superior Co., Ltd.）、
Kei Murayama（Shinko Electric Industries Co., Ltd.）、Hongwen Zhang（Indium Corporation）、
Anna Lifton、Morgana Ribas（MacDermid Alpha Electronics Solutions）、
Sarangapani Murali（Heraeus Materials Singapore Pvt.Ltd.）、
Terry Munson、Steve Middleton（Foresite）
(6) 技術賞（2 件）
「高速・高精度 CT 型 X 線検査技術」
（R&D から量産工程まで、Chiplet パッケージの接合工程安定化による量産歩留まり向上や、
TGV 先端工法開発の期間短縮など、様々なモノづくり現場ニーズに“非破壊”で応える）
村上清　（オムロン株式会社 X 線検査システム事業部）
「超高速フライング式プリント回路基板実装検査機の開発」
（バウンダリスキャン連携で更なる価値創出へ）」
柳田幸輝、山本昌裕（タカヤ株式会社）

【第 38 回春季講演大会優秀賞】
【13B1-3】 カーエレクトロニクス実装 1 セッション
「SiC デバイスを適用した車載向け両面冷却パワーモジュール実装構造の開発」
○長崎仁徳、徳山健、田中信太朗、平尾高志、井出英一、楠川順平、露野円丈、望月誠仁
株式会社日立製作所
【14C2-2】 3D・チップレット技術 セッション
「2 周波 ICP を用いた Small TSV Etching 技術の開発」
○鈴木大地、土居謙太、中村敏幸、森川泰宏　株式会社アルバック
【15B4-2】 部品内蔵・三次元造形 2 セッション
「立体配線成形技術の開発」
鳥井純一、西脇賢治、富塚稔瑞、小清水和敏　株式会社フジクラ
【14B2-2】 高速高周波・電磁特性・回路技術 6 セッション
「PTFE と低 CTE ポリイミドの直接接着法および低伝送損失基板の開発」
○土屋俊之[1]，小野光正[1]，梶丸大希[2]，山村和也[2]，大久保雄司[2]　[1]東洋紡株式会社，[2]大阪大学
【14D2-4】 バウンダリスキャン技術 セッション
「BGA 実装基板検査の最新動向　JTAG バウンダリスキャンテストとフライングプローブテスタのハイブリッド検査」
○柳田幸輝[1]，堀本亮貴[1]，坂本祐哉[1]，谷口正純[2]
[1]タカヤ株式会社，[2]アンドールシステムサポート株式会社

【第 38 回春季講演大会研究奨励賞】
【15D2-4】 インテリジェント実装設計技術 2 セッション
「深層学習によるサロゲートモデルを用いた実装基板の設計支援に向けた検討」
○清水嵩宥　株式会社東芝
【14A1-3】 サーマルマネージメント＆パワーエレクトロニクス実装 1 セッション
「ロックインサーモグラフィ周期加熱法を用いた半導体用放熱基板の界面熱抵抗測定」
○丹伊田春海　名古屋大学
【13C4-2】 高速高周波・電磁特性・回路技術 4 セッション
「多目的最適設計における範囲解拡大のための ANN モデル予測精度の学習データ量依存性評価」
○前川諒 岡山大学
【14D1-2】 官能検査システム化技術 セッション
「プローブ先端の外観検査におけるデータセットの水増しのための画像修復」
○青山颯 群馬大学

【13B4-2】 材料技術／環境調和型実装技術２
「自己還元性を有する低温焼結用銅粉の開発」
山岡尚樹 住友金属鉱山株式会社

【第 38 回春季講演大会ポスターアワード】
【14P1-4】 高速伝送実装　　座長：加藤義尚　(福岡大学)
「PWB の Skew に影響を与えるガラスクロス特性の調査」
〇宇佐見宙樹[1]，粟野昌弘[1]，畑中英之[1]，松井亜紀子[2]，安陪光紀[2]
[1]日東紡績株式会社，[2]NTT デバイスクロステクノロジ株式会社

【ICEP2024 Outstanding Technical Paper Award】
【FA2-3】
「Physical and Thermal Characteristics of the Advanced Package with Glass Core Substrate」
S. Mitarai, K. Adachi, T. Igarashi, K. Seki, N. Kakoiyama, Y. Tanaka, S. Oka, M. Nakazawa, H. Iwamoto (Sony Semiconductor Solutions / Japan)
【TB2-3】
「Characterization of Surface Activation on Nanotwinned Copper and SiCN by using Ar and N_2 Plasma」
Rou-Jun Lee[1], Pin-Syuan He[1], Wei-Lan Chiu[2], Hsiang-Hung Chang[2], Wei-You Hsu[1], Chih Chen[1] ([1]National Yang Ming Chiao Tung University, [2]Industrial Technical Research Institute / Taiwan)
【FB1-4】
「Advanced Fan-Out Embedded Chip Process Integration for 3D Application」
Chih-Cheng Hsiao, Chao-Kai Hsu, Ching-Iang Li, Yung-Sheng Chang, Ming-Ji Dai, Feng-Hsiang Lo, Chin-Hung Wang, Wei-Chung Lo (Industrial Technology Research Institute / Taiwan)
【TB4-1】
「Reliability Investigation of Cobalt and Copper Damascene Interconnects with Capped Graphene」
Y. T. Hung[1], J. Z. Huang[2], H. H. Chang[1], K. P. Huang[1], O. H. Lee[1], H. C. Chien[1], C. H. Wang[1], W. C. Lo[1], C. I. Wu[1,2], and K. N. Chen[1,3] ([1]Industrial Technology Research Institute, [2]National Taiwan University, [3]National Yang Ming Chiao Tung University / Taiwan)

【ICEP2024 JIEP Poster Award】
【P24】
「Comparison of Mechanical Property and Thermal Cycling Lifetime of Sintered Cu and Sintered Ag」
Dai Ishikawa[1], Hideo Nakako[1], Thomas Blank[2], Felix Steiner[2] ([1]Resonac / Japan, [2]Karlsruhe Institute of Technology / Germany)
【P12】
「Investigation of Plasma Gases for Polysilazane Conversion into SiO_2 for Wafer Bonding」
Daiki Nemoto, Kai Takeuchi, Eiji Higurashi (Tohoku University / Japan)

【MES2024 ベストペーパー賞】
【12A2-2】先端プロセス・実装技術セッション
「ハイブリッド接合における洗浄プロセスと Cu パッドリセスの関係」
〇小池美夏，千代薗修典，古瀬駿介，藤井宣年，琴尾健吾，小川直樹，齋藤卓，萩本賢哉，岩元勇人
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
【13A3-3】最先端材料セッション
「低温 Cu-Sn 遷移的液相拡散接合のための Sn-Bi 合金活用法の検討」
〇黒沢憲吾[1]，大口健一[2]，福地孝平[2]，和合谷繁満[3]，吉田浩平[3]
[1] 秋田県産業技術センター，[2] 秋田大学，[3] 東電化工業株式会社
【13B2-2】信頼性技術２セッション
「Si ダイ / アンダーフィル界面の疲労き裂進展速度におよぼす球状シリカフィラー添加量および粒度分布の影響」
〇田中宏樹[1]，苅谷義治[1]，榎本利章[2]，山口博[2]，吉田拓弥[2]
[1] 芝浦工業大学，[2] ナミックス株式会社
【13D2-3】シミュレーション・計算機による評価・設計セッション
「放熱材中のフィラーと樹脂間のフォノン伝導による３次元熱伝達解析」

○荒尾修，狐塚勝司，新帯亮　株式会社デンソー
【13D4-2】めっき技術セッション
「高密着銅めっき回路形成技術のフィルムやガラス基板への応用」
川上 雄介 株式会社ニコン

【MES2024 研究奨励賞授賞】
【12A1-3】先端プロセス・実装技術セッション
「3D 積層デバイス向け TSV の Cu pumping 評価」
○山野友梨子　ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
【13A1-2】パワーエレクトロニクス実装技術セッション
「SiC パワーデバイスのための過渡熱抵抗測定システムの開発」
○福永崇平　大阪大学
【13A4-2】 最先端材料セッション
「金属架橋型導電性接着剤の架橋が銅との接合強度にもたらす影響」
○平林湧　大阪大学大学院
【13B1-3】信頼性技術 2 セッション
「Ni-P/Au めっきによる Sn-Bi 系合金バンプ継手特性評価」
○川上夏輝　大阪大学
【13C1-2】プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス セッション
「インプラント構造を用いた硬さセンサの開発とウェアラブル応用」
○奈良健汰　山形大学

【MES2024 ポスターアワード】
【12P1-1】めっき技術分野
「ガラス上の酸化グラフェン層形成による高密着無電解銅めっき開発」
○中筋渉[1]，郷田隼[2]，川﨑英也[1]　[1]関西大学，[2] 株式会社日本触媒
【12P1-3】先端プロセス・実装技術分野
「Au薄膜の転写とコイニングにより作製した平坦なAuマイクロバンプアレイ」
○後藤慎太郎[1]，竹内魁[1]，日暮栄治[1]，レハクホウントゥー[2]，松前貴司[2]，高木秀樹[2]，倉島優一[2]
[1] 東北大学，[2]産業技術総合研究所

11. その他の活動報告（定款第 4 条第 5 号関係）

(1) 関連学協会の各種事業との協力活動

電子情報通信学会、応用物理学会、電気学会、溶接協会、表面技術協会など 30 学協会、46 件の講演大会・シンポジウムなどの行事について協賛・後援した。一方、秋季大会 MES および春季講演大会では 39 学協会から協賛を受け、相互に交流を深めました。支部レベルでは、関西にある他の学協会支部と相互に協賛を行い活動の活性化に寄与した。

12. 2025 年 3 月 31 日現在の会員数

正 会 員	2,028 名	（前年同期比 115 名増）
学生会員	83 名	（前年同期比　8 名増）
賛助会員	178 社	（前年同期比　9 社増）
賛助会員口数	272 口	（前年同期比　29 口増）

以上